

トップ LECS プロセス

TOP LECS PROCESS

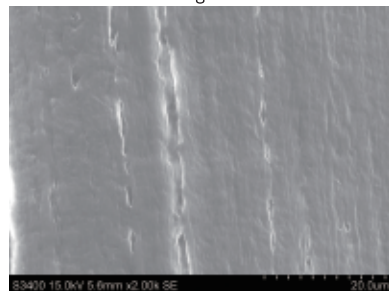
- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへのめっきプロセス
Realize plating to LCP films suitable for high-frequency, high-speed transmission
- Roll to Roll処理に適しためっきプロセス
Applicable for Roll to Roll equipment
- 表層の平滑性を維持し、かつ高い密着性が得られる
Control surface roughness, ensure high adhesive performance
- セミアディティブプロセスに対応し、ファインパターン性に優れる
Applicable for SAP and excellent in fine pattern ability

低粗度でも高いピール強度が得られ、高速伝送に最適

High peel strength to low Ra material, suitable for high-speed transmission

表面改質前

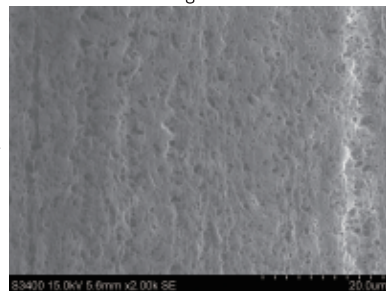
Before surface reforming



Ra=64 nm

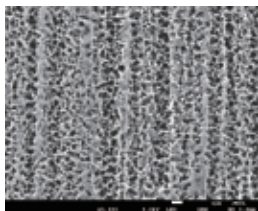
表面改質後

After surface reforming



Ra=116 nm

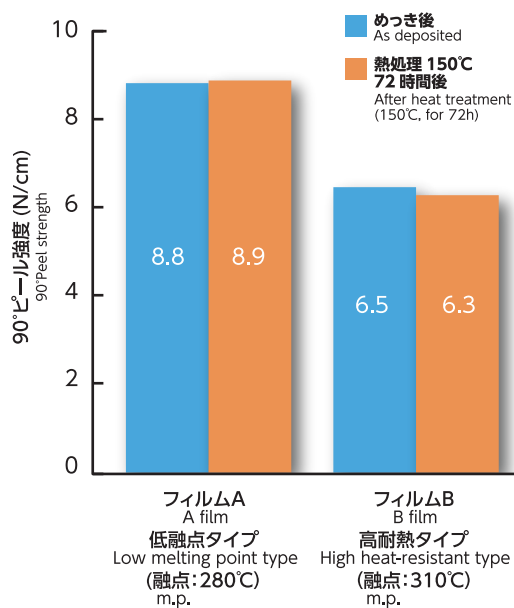
LCP-CCL 基板の銅箔部エッチング後
LCP material based CCL



Ra=284 nm

**独自の表面改質処理で
表面粗さを抑えつつ、
高い密着性を確保!**

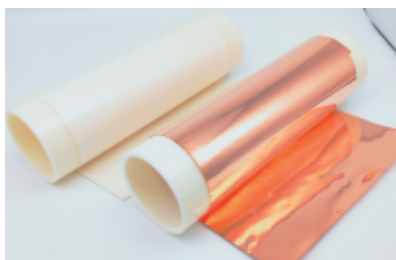
Control surface roughness by
original surface-modifying treatment,
ensure high adhesive performance



ピール強度の比較 (銅膜厚 18 μm)
Comparison of peel strength Cu thickness

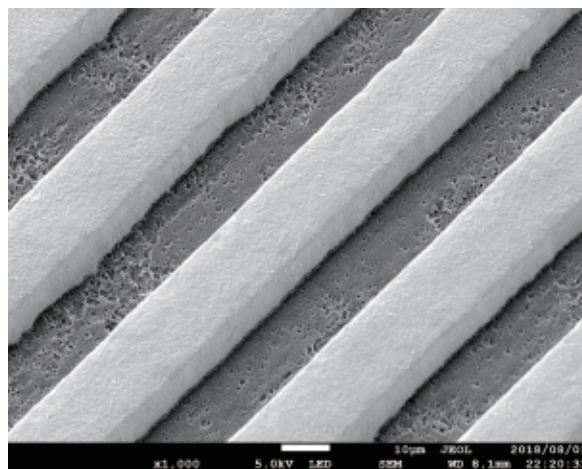
Roll to Rollによる無電解銅めっきが可能

Realize electroless copper plating by Roll to Roll equipment



ファインパターン性に優れる

Excellent in fine pattern ability



L/S=20/20 μm

パラジウム吸着量が低く、パターンニング性に優れる
Reduce Pd adsorption amount, excellent in patterning performance